

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：460110

[44]中華民國 90年 (2001) 10月 11日

新型

全 4 頁

[51] Int.Cl 06: H05K7/20

H05K7/12

[54]名稱：電腦中央處理器散熱結構

[21]申請案號：089204275

[22]申請日期：中華民國 89年 (2000) 03月 17日

[72]創作人：

魏文珍

台北縣八里鄉中山路十九之四號

[71]申請人：

魏文珍

台北縣八里鄉中山路十九之四號

[74]代理人：

1

2

[57]申請專利範圍：

一種電腦中央處理器散熱結構，主要係在於散熱片可前後卡扣組合成複數散熱片組，其特徵在於：上述散熱片在上、下兩端緣水平延伸設置卡槽與卡勾，並在下端沿直角折設有導熱翼片，其中，該卡槽係自散熱片本體延接兩支腳而概呈反匚型，卡槽延伸之寬度與導熱翼片同寬，且卡槽自中央處再向前延伸形成卡勾，該卡勾為一凸片而概呈波浪凹折狀，卡勾之寬度略小於卡槽之槽孔，使可嵌扣於槽孔，俾供散熱片得以前後對應扣合而形成溝狀排列之導流散

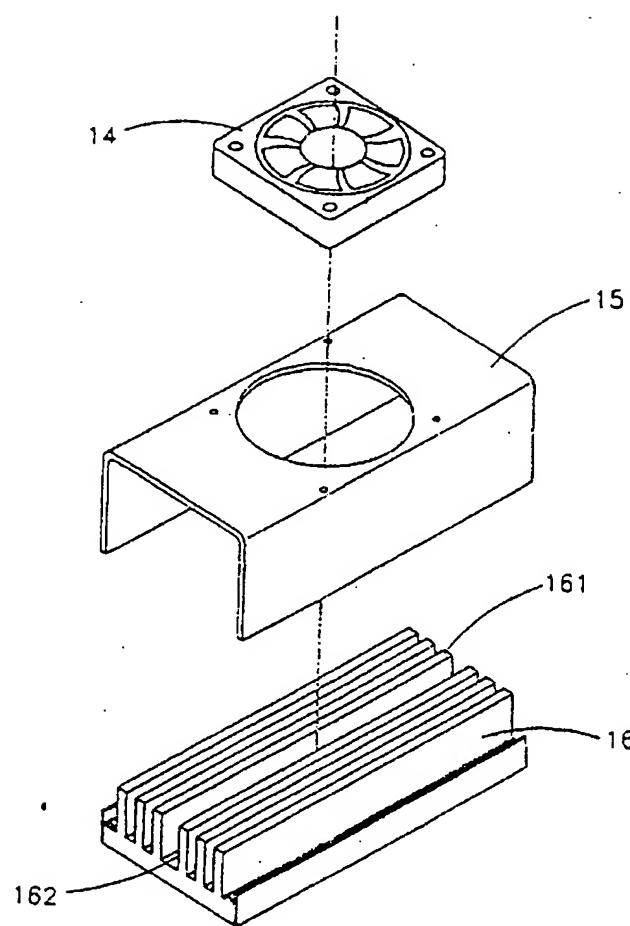
熱區，同時底部之導熱翼片靠合併成綿密之導熱接觸面，而與底板熱源之吸熱面積完全接觸者。

圖式簡單說明：

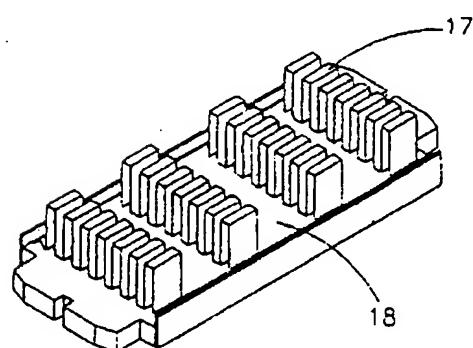
5. 第一圖係習知散熱裝置之立體圖。
10. 第二圖係習知另一散熱裝置之立體圖。
15. 第三圖係本創作之組合關係圖。
20. 第四圖係本創作散熱片之立體組合圖。
25. 第五圖係本創作散熱片組合底部示意圖。

BEST AVAILABLE COPY

(2)



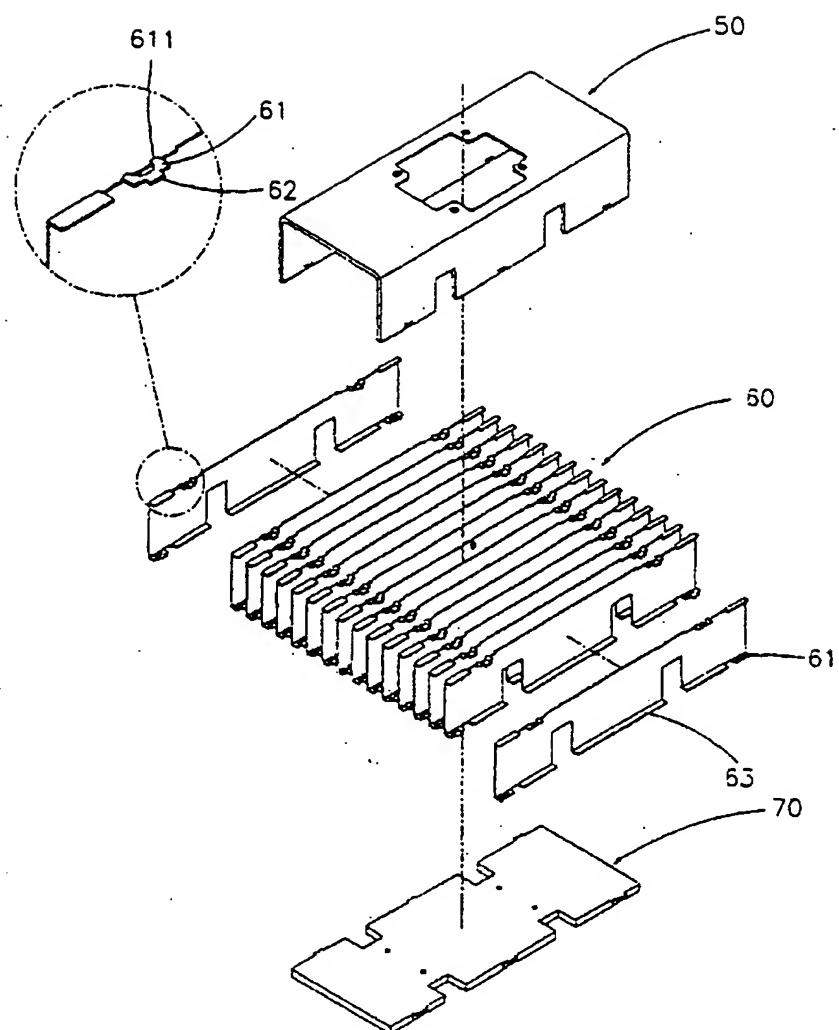
第一圖



第二圖

BEST AVAILABLE COPY

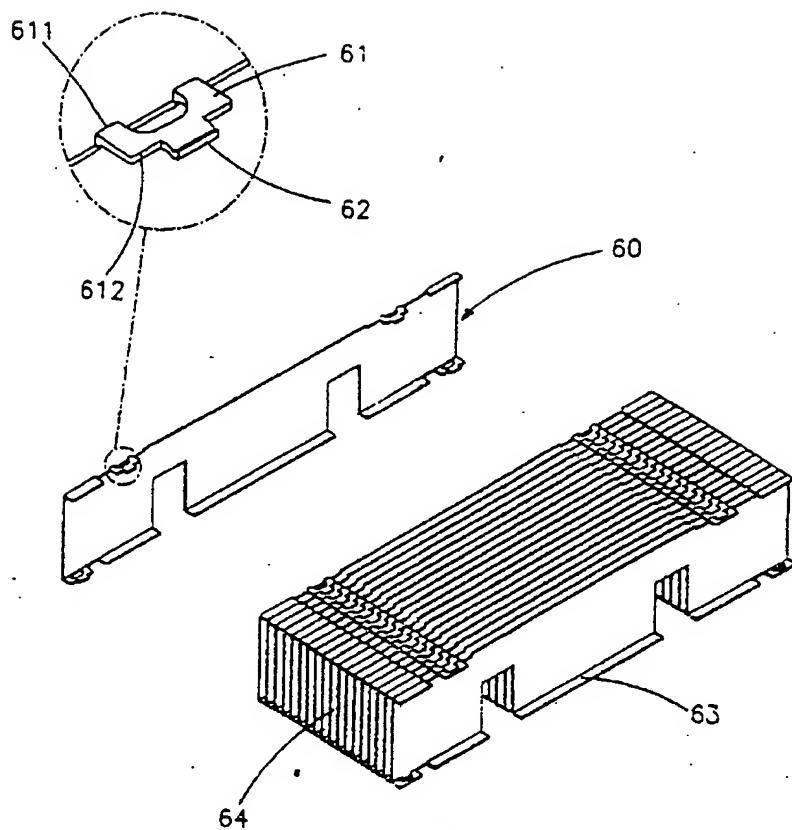
(3)



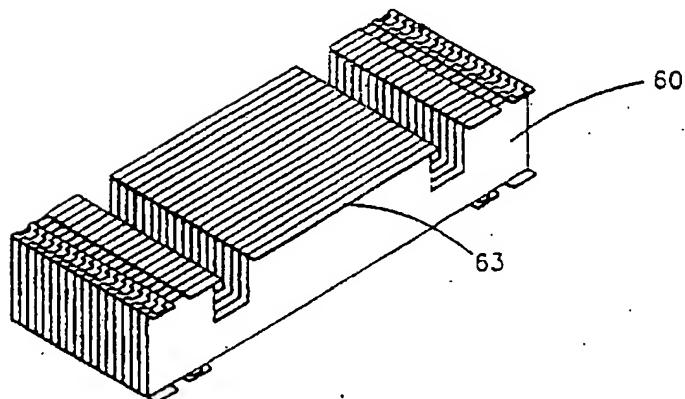
第三圖

BEST AVAILABLE COPY

(4)



第四圖



第五圖

BEST AVAILABLE COPY